

# プログラム

「鉛フリーはんだ再考」 -Sn-Ag-Cu系はんだの信頼性・その実力と課題-

日 時：平成18年 11月10日（金） 10:30～16:35

場 所：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟大講義室

時 間	講 演 題 目	講 演 者
10:30～ 10:35	開会の挨拶	
<b>基 調 講 演</b>		
10:35～ 11:05	『 これからのエレクトロニクス製品における信頼性 』	富士通(株) : 西原幹雄
11:05～ 11:15	休 憩	
<b>セッション1:材料</b>		
11:15～ 11:40	『 Sn-Ag-Cu系はんだの組織と力学的特徴 』	芝浦工業大学 : 苅谷義治
11:40～ 12:05	『 Sn-3Ag-0.5Cuはんだと無電解 Ni/Auめっき電極の接合強度 』	群馬大学 : 荘司郁夫
12:05～ 13:05	昼休み	
<b>セッション2:製品レベルにおける信頼性課題1</b>		
13:05～ 13:30	『 角チップ部品実装接合部の温度サイクル疲労特性 』	千住金属工業(株) : 上島 稔
13:30～ 13:55	『 大型基板対応鉛フリーリフロー ソルダリング工程構築の問題点と対策 』	日本IBM(株) : 藤内伸一
13:55～ 14:05	休 憩	
<b>セッション3:製品レベルにおける信頼性課題2</b>		
14:05～ 14:30	『 携帯電話への鉛フリーはんだ導入事例 』	ソニー・エリクソン・ モバイルコミュニケーションズ(株) : 志村俊幸
14:30～ 14:55	『 鉛フリーはんだ付部のウイスカ発生メカニズム 』	(株)デンソー : 吉野 睦
14:55～ 15:15	コーヒーブレイク	
<b>セッション4 評価・解析手法</b>		
15:15～ 15:40	『 鉛フリーはんだ接合部の熱疲労信頼性評価 』	横浜国立大学 : 澁谷忠弘
15:40～ 16:05	『 はんだ接続部の衝撃強度評価 』	(株)日立製作所 : 矢口昭弘
16:05～ 16:30	『 熱負荷の影響を考慮した 振動負荷に対する疲労損傷評価 』	大阪大学 : 松嶋道也
16:30～ 16:35	閉会の挨拶	

プログラム内容および講演者名などの一部が変更になることがあります。ご了承ください。